



BAMFIT Bonder / Tester 5600

Test System

Testkopf	Das speziell entwickelte Klemmwerkzeug greift den Bondfuß seitlich bei definierter Höhe; ein Touchdown-System gleicht Variierende Substrathöhen automatisch aus.
Testwerkzeug	für Dickdrähte von 125 bis 500 µm; für Ball-Bonds ab 50 µm Drahtstärke; durch den Bediener in Minuten austauschbar
Testkraft	Zugkraft in Z-Richtung, typ. 20 bis 40 cN
Testfrequenz	60 und 80 kHz, programmierbarer Ultraschall-Generator
Testamplitude	entspricht dem Temperaturhub beim PC Test; programmierbar von 0 bis 1 µm
Testdaten	Toolposition und Ultraschalldaten werden laufend registriert und zur späteren Auswertung in SQL-Datenbank gespeichert

BAMFIT-Tester

Das revolutionäre **BAMFIT-Testverfahren** ist durch einen speziellen Testkopf sehr einfach an jedem Basisgerät der Serie 56XX installierbar.

Die Software ist der Standard-Version für Bonder und Tester sehr ähnlich und erlaubt voll-automatisches Testen von beliebig vielen Bonds mit automatischer Feinjustierung der Testposition durch Bilderkennung.

Die Testresultate werden in einer SQL-Datenbank gespeichert und können jederzeit ausgewertet werden.

BAMFIT Zuverlässigkeits-Test

BAMFIT (Bond Accelerated Mechanical Fatigue Interconnection Test) ist ein völlig neuartiges Testverfahren, um Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Dickdraht-Wedgebonds und Dünndraht-Ballbonds abzuschätzen. Es ist die perfekte Erweiterung des klassischen Power-Cycling-Tests (PC): die zyklische Stressbelastung des Drahtbonds durch Temperaturwechsel wird durch mechanischen Stress nachgebildet, aber mit bedeutend höherer Zyklusgeschwindigkeit. Dadurch können PC-Tests, die häufig Wochen oder Monate dauern, innerhalb von Minuten simuliert werden.

Maschinenbasis

Arbeitsbereich	X/Y-Achse 100x100 mm / Z-Achse 60 mm
Achsen	Schrittauflösung 0,25 µm; Wiederholgenauigkeit <2 µm
Testkopf	Austauschbare Bond- und Testköpfe mit automatischer Erkennung
Hardware	Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor, 4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front, Firewire CCD Farbkamera mit programmierbarer Bilderkennung
Software	Manuelle oder automatische Messungen an beliebig vielen Bonds
Abmessung	B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80 kg
Anschlüsse	100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max. 500 VA Standard-Vakuumschlauch Ø 6 mm

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at

Hilpert
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:
Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse
Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

